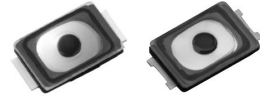


3.0 mm × 2.0 mm型 SMD轻触开关

Type: EVPAW



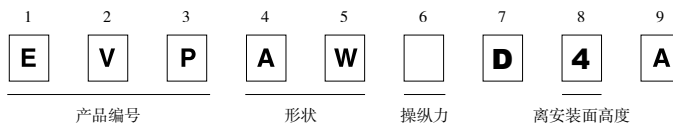
■ 特点

- 外形尺寸：3.0 mm × 2.0 mm，高度0.6 mm
- 带传动点，确保良好的操作性能
- 对应IP67

■ 主要用途

- 便携式电子设备(移动电话、便携式音响设备等)的操作开关

■ 型号命名方式



■ 主要规格

种类		按动式单级单投
电气特性	额定	10 μA 2 V DC ~ 20 mA 15 V DC(电阻负载)
	接触电阻	500 mΩ 以下
	绝缘电阻	50 mΩ 以上 (100 V DC)
	耐电压	250 V AC (1 分钟)
	振动	10 ms 以下 (ON, OFF)
机械特性	操纵力	1.6 N, 2.4 N, 3.3 N
	行程	1.6 N, 2.4 N : 0.13 mm 3.3 N : 0.15 mm
耐用性	使用寿命	1.6 N, 2.4 N : 500,000 次以上 3.3 N : 300,000 次以上
IP67(*1)	IP6x(防尘性)	滑石4种 8 小时
	IPx7(防水性)	1m 30 分钟浸泡
使用温度范围		- 40 °C ~ + 85 °C
保存温度范围		- 40 °C ~ + 85 °C (单件) - 20 °C ~ + 60 °C (带状包装)
最小包装数量		10,000 个 模压带包装(盘卷包装)
包装箱容量		50,000 个

备注：注意不能清洗。

(*1)IP67：开关为放置状态，不动作。在规定条件下，无对开关特性产生不利影响的粉尘和水的侵入。但IP67(防尘性、防水性)是单开关状态下保证的性能，某些封装状态和使用方法可能无法保证。因此，对于防尘、防水特性尤显重要的使用场合，请联系我们。

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时，请速与本公司联系。

■ 外观尺寸 (mm)

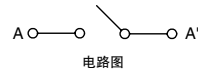
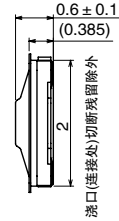
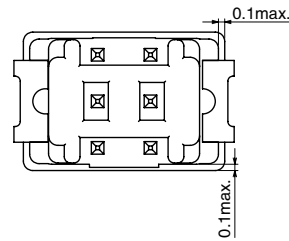
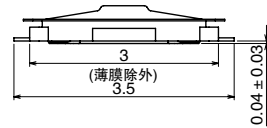
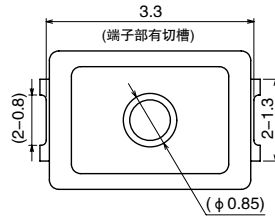
EVPAW

(模压带包装品)
有切槽端子产品

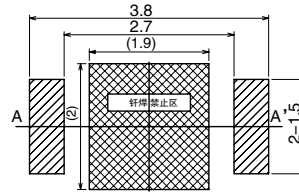


一般尺寸公差: ± 0.05
()尺寸为参考尺寸

*规格有变更的可能



焊锡模板厚度为0.1 mm,
开口率为焊盘图案的60%~100%。
(推荐80%)



印刷电路板焊盘参考图

* 焊锡涂层不均会导致封装钎焊失败,
因此请使用推荐焊锡层和焊盘图案。

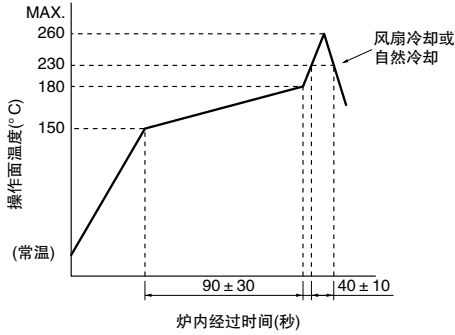
▨:推荐焊盘图案区
▩:钎焊禁止区

请勿在▩区域配置焊盘图案和过孔。
需配置焊盘图案或过孔时, 为避免金属部分外露,
请进行绝缘涂层和抗蚀剂处理。
金属部分外露, 可能会因焊锡球导致与开关背面
端子部之间短路。
此外, 铜箔厚度和图案布局产生的凹凸差, 会对开关
的倾斜和与焊锡的接合状态、助焊剂渗透造成影响。
因此, 请在使用前进行验证。

型号	操纵力	离安装面高度	使用寿命
EVPAWBD4A	1.6 N	0.6 mm	500,000 次
EVPAWCD4A	2.4 N	0.6 mm	500,000 次
EVPAWED4A	3.3 N	0.6 mm	300,000 次

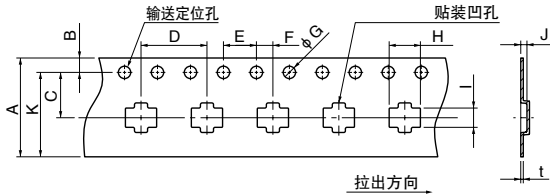
本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时, 请速与本公司联系。

■ 推荐回流焊条件



● 模压载带包装件

12 mm带宽(A=12.0 mm)



- * 表面覆盖膜剥离强度0.2 N ~ 0.1 N。(剥离角度165°)
- * 封装状态下的产品脱落数为1个以内, 但是一个卷盘内的数量确保。
- * 载带接口处1个卷盘里1处以内。

单位: mm

型号	产品高度	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	t
EVPAW	0.6	12.0 ± 0.3	1.75 ± 0.10	5.5 ± 0.1	8.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	1.5 ± 0.3	3.8 ± 0.2	2.3 ± 0.2	0.75 ± 0.20	(10.25)	0.3 ^{+0.15} / _{-0.10}

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时, 请速与本公司联系。